

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2002 年 9 月 12 日 (12.09.2002)

PCT

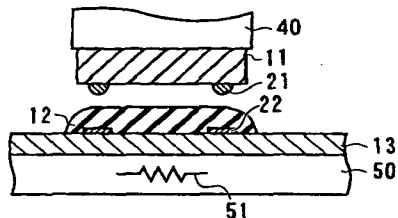
(10) 国際公開番号  
WO 02/071469 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: H01L 21/60 千103-8312 東京都中央区日本橋室町一丁目6番3号 Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP02/01284
- (22) 国際出願日: 2002 年 2 月 15 日 (15.02.2002)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願2001-49615 2001 年 2 月 26 日 (26.02.2001) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ソニーケミカル株式会社 (SONY CHEMICALS CORP.) [JP/JP];
- (72) 発明者; および
- (73) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 熊倉 博之 (KUMAKURA, Hiroyuki) [JP/JP]; 千322-8502 栃木県鹿沼市さつき町12-3 ソニーケミカル株式会社第2工場内 Tochigi (JP).
- (74) 代理人: 石島 茂男, 外 (ISHIJIMA, Shigeo et al.); 千105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目2番18号 虎ノ門興業ビル3階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): CN, KR, US.
- 添付公開書類:  
— 国際調査報告書

[続葉有]

(54) Title: ELECTRIC DEVICE PRODUCING METHOD

(54) 発明の名称: 電気装置製造方法



(57) Abstract: In a method of producing an electric device (1), an adhesive agent (12) together with a flexible wiring board (13) is heated to a first heating temperature and, after a sufficient lowering in viscosity, the positioning of a semiconductor chip (11) is effected, and therefore no air is carried in when the semiconductor chip (11) is placed on the adhesive agent (12). Further, during main pressure joining, the adhesive agent (12) is heated to a second heating temperature higher than the first heating temperature, increasing the viscosity of the adhesive agent (12), so that the remaining voids are pushed out together with the excess of the adhesive agent (12). Therefore, there is obtained an electric device (1) of high conduction reliability, with no voids in the adhesive agent (12).

(57) 要約:

本発明の電気装置1製造方法では、フレキシブル配線板13と共に、接着剤12を第一の加熱温度に加熱し、十分に粘度が低下した後、半導体チップ11の位置合わせを行うので、半導体チップ11が接着剤12に載せられる際に、空気が巻き込まれない。また、本圧着の際には、接着剤12が第一の加熱温度よりも高い第二の加熱温度に加熱され、接着剤12の粘度が高くなるので、残留したボイドが余分な接着剤12と共に押し出される。従って、接着剤12中にボイドが無く、導通信頼性の高い電気装置1が得られる。

WO 02/071469 A1



2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。